

## 深圳市力合微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“力合微”）截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1272 号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，发行价为每股人民币 17.91 元，共计募集资金 48,357.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,221.49 万元后的募集资金为 45,135.51 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2020 年 7 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,580.36 万元后，公司本次募集资金净额为 42,555.16 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-58 号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 12 月	备注

			31 日余额	
华夏银行股份有限公司深圳南头支行	10868000000273280	6,674.00	536.69	活期存款
华夏银行股份有限公司深圳南头支行	10868000000273268	6,421.00	915.86	活期存款
华夏银行股份有限公司深圳南头支行	10868000000273279	5,046.00	533.73	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行	79290078801800001582	13,646.00	87.12	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行	79290078801600001583	10,768.16	32.31	活期存款
中国银行股份有限公司深圳侨香支行	767973971419		0.41	活期存款
中国银行股份有限公司深圳侨香支行	764073970587		0.87	活期存款
中国银行股份有限公司深圳侨香支行	777073971086		4.49	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	66150078801200001002		3.01	活期存款
中国民生银行股份有限公司深圳分行南海支行	655099966			已销户
中国民生银行股份有限公司深圳分行南海支行	677168886			已销户
中国工商银行股份有限公司深圳华强支行	4000022161002000869		5,000.00	结构性存款
平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行	0412100094572		7,300.00	结构性存款
招商银行股份有限公司深圳高新园支行	75594848568100017		3,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司深圳高新园支行	75594848568100051		1,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司深圳高新园支行	75594848568200030		2,000.00	大额存单
招商银行股份有限公司深圳高新园支行	75594848568200044		1,000.00	大额存单
招商银行股份有限公司深圳高新园支行	75594848568200061		1,000.00	大额存单

上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行	79290078801800000417		4,500.00	购买结构性存款冻结资金
合 计		42,555.16	26,914.49	

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

### (一) 前次募集资金投资项目增加实施主体的情况

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意增加成都力合微电子有限公司（以下简称成都力合微）和深圳市利普信通科技有限公司（以下简称利普信通）作为新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目的实施主体、增加成都力合微和利普信通作为微功率无线通信芯片研发及产业化项目的实施主体、增加利普信通和长沙力合微智能科技有限公司作为基于自主芯片的物联网应用开发项目的实施主体，同时使用部分募集资金对全资子公司提供无息借款以实施募投项目。

### (二) 前次募集资金投资项目实施主体和实施地点变更的情况

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，自 2021 年 4 月 20 日后，成都力合微不再承担募投项目“新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目”和“微功率无线通信芯片研发及产业化项目”的研发任务。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。成都力合微已将所有产生的研发成果转交移至力合微公司，成都力合微于 2021 年 8 月 18 日注销在中国民生银行股份有限公司深圳分行南海支行开立的两个募集资金专项账户。变更部分募投项目实施主体和实施地点情况如下表：

金额单位：人民币万元

项目名称	变动对比	实施主体	募集资金投资额	实施地点
新一代高速电力线通信芯片研发及产业化	变更前	力合微公司	4,877.00	深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101、陕西省西安市高新区科技路二路 72 号西安软件园唐乐阁 D 座 2 楼 D201-4 室、中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 500 号 1 栋 28 层 2836 号、深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1102
		成都力合微	1,003.00	
		利普信通	541.00	
		合计	6,421.00	
	变更后	力合微公司	5,835.00	
		成都力合微	45.00[注]	
		利普信通	541.00	
		合计	6,421.00	
微功率无线通信芯片研发及产业化项目	变更前	力合微公司	3,896.00	深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101、中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 500 号 1 栋 28 层 2836 号、深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1102
		成都力合微	597.00	
		利普信通	553.00	
		合计	5,046.00	
	变更后	力合微公司	4,481.00	
		成都力合微	12.00[注]	
		利普信通	553.00	
		合计	5,046.00	

[注] 自 2021 年 4 月 20 日后，成都力合微不再承担“新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目”和“微功率无线通信芯片研发及产业化项目”的研发任务，变更后的成都力合微募集资金投资额为截至 2021 年 4 月 20 日已实际投入的金额。

### （三）前次募集资金变更募投项目和募投项目延期的情况

原研发测试及实验中心建设项目中规划以购置方式取得办公用房的建筑面积约为 1,250 平方米，公司目前以自有资金租用研发场地，以募集资金采购部分项目所需的设备及软件。随着公司规模的不发展壮大，公司对研发和经营场地的需求日益增加。综合考虑募投项目实施情况和公司长远发展规划，公司拟计划使

用募集资金和自有资金以联建方式建设约 6,000 平方米（最终以实际建设面积为 准）研发中心和总部基地。募投项目实施方式调整为自建办公场所相对于直接购置办公场地所获得的办公面积更大，有利于公司研发和运营的投入，有利于办公环境的改善和企业文化的贯彻，有利于公司招募更多的研发技术人才，更符合公司成本与效益的要求。

公司于 2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，并于 2021 年 12 月 28 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目和募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研发测试及实验中心建设项目”名称变更为“研发中心与总部基地建设项目”，该项目中的“研发场地投资”实施方式由购买办公场地变更为购买土地并自建研发中心与总部基地；同时该项目达到预定可使用状态的时间由 2022 年 3 月延期到 2027 年 3 月；此处自建研发中心与总部基地的投资总额为 16,285 万元，项目所需资金拟使用募集资金和自有资金，其中募集资金投入 13,646 万元，剩余金额以自有资金投入。本次变更用途的募集资金总额为 13,646.00 万元，变更用途的募集资金总额比例为 32.07%。同时公司拟将“新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目”和“基于自主芯片的物联网应用开发项目”募投项目达到预定可使用状态日期，由原计划的 2022 年 3 月延长至 2024 年 3 月；募投项目“微功率无线通信芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期，由原计划的 2022 年 3 月延长至 2023 年 3 月。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《关于变更募投项目和募投项目延期的公告》（公告编号：2021-058）。

#### 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

首次公开发行募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明（单位：万元）

实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额差异	差异原因

				金额	
研发中心与总部基地建设项目	13,646.00	13,646.00	801.76	-12,844.24	尚处于建设期
新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目	6,421.00	6,421.00	4,297.18	-2,123.82	尚处于建设期
微功率无线通信芯片研发及产业化项目	5,046.00	5,046.00	2,051.24	-2,994.76	尚处于建设期
基于自主芯片的物联网应用开发项目	6,674.00	6,674.00	3,233.35	-3,440.65	尚处于建设期
合计	31,787.00	31,787.00	10,383.53	-21,403.47	

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

研发中心与总部基地建设项目无法单独核算效益；新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目、微功率无线通信芯片研发及产业化项目和基于自主芯片的物联网应用开发项目尚处于建设期，未实现收益。详见本报告附件 2。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发测试及实验中心建设项目主要通过建设专业的芯片设计研发测试中心、电力线通信技术实验中心和无线通信技术实验中心，改善研发工作的软件开发条件，提高研发的质量和水平，为公司的可持续健康发展提供技术支撑服务，间接提高公司效益。

### (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

## 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明。

## 八、闲置募集资金的使用

2020年7月31日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4.18亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效；董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品或业务品种、签署合同及协议等。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。

2021年7月26日，公司召开第三届董事会第八次（临时）会议及第三届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币3.34亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用；董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品或业务品种、签署合同及协议等。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。截至2021年12月31日，公司合计使用24,800万元进行现金管理，其中购买结构性存款16,300万元，大额存单4,000万元，4,500万元用于购买结构性存款，因银行结构性存款产品成立日为2022年1月4日，故该款项在期末尚未完成扣款，为存放在一般存款账户的购买结构性存款冻结资金。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金余额为 26,914.49 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 138.64 万元，理财收益 1,004.22 万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 6,400.00 万元。本公司募集资金净额 42,555.16 万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为 63.25%，剩余资金将继续用于实施承诺投资项目。

## 十、超募资金使用情况

1. 2020 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,200 万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。

2. 2021 年 9 月 26 日，公司第三届董事会第十次（临时）会议及第三届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,200 万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已实际使用 6,400 万元超募资金永久补充流动资金，剩余尚未使用的超额募集资金仍存放于公司募集资金专项账户。

## 十一、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 10 日



附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市力合微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：42,555.16						已累计使用募集资金总额：16,783.53				
变更用途的募集资金总额：13,646.00 变更用途的募集资金总额比例：32.07%						各年度使用募集资金总额： 2021 年：8,994.42 2020 年：7,789.11				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	研发测试及实验中心建设项目	研发中心与总部基地建设项目	13,646.00	13,646.00	801.76	13,646.00	13,646.00	801.76	-12,844.24	2027 年 3 月[注 1]
2	新一代高速电力线通信芯片研发及产业化	新一代高速电力线通信芯片研发及产业化	6,421.00	6,421.00	4,297.18	6,421.00	6,421.00	4,297.18	-2,123.82	2024 年 3 月[注 2]

	项目	项目								
3	微功率无线通信芯片研发及产业化项目	微功率无线通信芯片研发及产业化项目	5,046.00	5,046.00	2,051.24	5,046.00	5,046.00	2,051.24	-2,994.76	2023年3月[注3]
4	基于自主芯片的物联网应用开发项目	基于自主芯片的物联网应用开发项目	6,674.00	6,674.00	3,233.35	6,674.00	6,674.00	3,233.35	-3,440.65	2024年3月[注4]
承诺投资项目小计			31,787.00	31,787.00	10,383.53	31,787.00	31,787.00	10,383.53	-21,403.47	
5	超募资金	永久补充流动资金	不适用	6,400.00	6,400.00	不适用	6,400.00	6,400.00		不适用
6		暂未确定用途超募资金	10,768.16	4,368.16		10,768.16	4,368.16		-4,368.16	不适用
超募资金小计			10,768.16	10,768.16	6,400.00	10,768.16	10,768.16	6,400.00	-4,368.16	
合计			42,555.16	42,555.16	16,783.53	42,555.16	42,555.16	16,783.53	-25,771.63	

[注1]研发测试及实验中心建设项目名称变更为研发中心与总部基地建设项目，项目延期情况详见本报告三(三)之说明

[注2]项目延期情况详见本报告三(三)之说明

[注3]项目延期情况详见本报告三(三)之说明

[注4]项目延期情况详见本报告三(三)之说明

附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市力合微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2021 年	2020 年	2019 年		
1	研发中心与总部基地建设项目[注 1]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目[注 2]	不适用	未做承诺	建设期	建设期	不适用	不适用	不适用
3	微功率无线通信芯片研发及产业化项目[注 3]	不适用	未做承诺	建设期	建设期	不适用	不适用	不适用
4	基于自主芯片的物联网应用开发项目[注 4]	不适用	未做承诺	建设期	建设期	不适用	不适用	不适用
5	超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]该项目可以改善研发工作的软硬件开发条件，提高研发的质量和水平，不直接产生经济效益

[注 2]截至 2021 年 12 月 31 日，该项目尚处于建设期，未实现收益

[注 3]截至 2021 年 12 月 31 日，该项目尚处于建设期，未实现收益

[注 4]截至 2021 年 12 月 31 日，该项目尚处于建设期，未实现收益